南通富士通微电子股份有限公司

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2014-015

2013年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	通富微电	股票代码	002156
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	钱建中	丁燕	
电话	0513-85058919	0513-85058919	
传真	0513-85058929	0513-85058929	
电子信箱	nfme_stock@fujitsu-nt.com	nfme_stock@fujitsu-nt.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,767,322,278.64	1,590,025,442.22	11.15%	1,622,046,684.09
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,660,291.84	37,840,342.98	60.31%	49,028,221.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,543,501.43	15,068,586.03	76.15%	7,179,794.15
经营活动产生的现金流量净额(元)	309,429,452.35	179,953,066.64	71.95%	5,939,203.15
基本每股收益(元/股)	0.09	0.06	50%	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.06	50%	0.08
加权平均净资产收益率(%)	2.72%	1.72%	1%	2.27%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	3,686,188,070.23	3,382,396,573.65	8.98%	3,390,223,114.94
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,256,122,777.31	2,208,676,173.87	2.15%	2,180,581,960.23

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数			38,269	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		49,142
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
南通华达微电子集团有限公司	境内非国有法人	36.93%	239,990,400	0	质押	77,030,000
富士通(中国)有限公司	境外法人	24.62%	159,993,600	0		0
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期	其他	0.75%	4,900,000	0		0
平安信托有限责任公司-投信精英之淡水泉	其他	0.72%	4,709,472	0		0
平安信托有限责任公司-平安财富淡水泉成长一期集合信托	其他	0.58%	3,748,778	0		0
加拿大年金计划投资委员会-自有资金	境外法人	0.49%	3,173,590	0		0
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	其他	0.41%	2,640,079	0		0
平安信托有限责任公司-淡水泉三期	其他	0.32%	2,069,991	0		0
江苏瑞翌投资有限公司	境内非国有法人	0.27%	1,728,597	0		0
刘远强	境内自然人	0.24%	1,583,302	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东股东中,第1和第2名股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东江苏瑞翌投资有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,286,500股。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

(1)概述

2013年,全球经济呈现出不均衡发展态势,美、日本经济较2012年有所回升,欧元区经济持续疲软,国内方面,面临结构调整和产业转型升级的复杂局面,2013年,人民币升值、行业竞争加剧、人力成本和管理成本上升等因素给公司的经营管理带来了不小的挑战;另一方面,以智能手机为主的智能终端产品市场规模扩大,节能减排需求的增长以及可穿戴设备等的异军突起,给集成电路行业注入强大活力和带来巨大成长空间。

在这样的宏观环境下,公司管理层积极应对,在股东大会和董事会的正确决策和领导下,公司上下齐心协力,通过进一步调整产品结构和市场布局,全面提升绩效管理、加快技术创新、加强成本管控,实现了公司健康、稳定的发展,报告期内公司主要完成了以下几个方面工作:

(一)生产经营方面

1、依据不断变化的市场,调整市场策略,着力推进公司优势产品。BGA、QFN等先进封装产品销售额同比增长35%以上,POWER产品销售额同比增长40%以上;

2、积极采取各种措施,上下同心,合力缓解用工难的矛盾;

3、为更好发挥员工的积极性,提高经营效率,保持产品质量的稳定和提高,公司强化了绩效考核,取得了显著实效,在人力资源紧张的状况下,实现增产又增益,生产效能明显提升。2013年公司产量同比增长16%。

(二)技术创新方面

1、以降低成本为重点的技术研发与应用工作扎实推进,铜线技术应用从传统封装产品扩展到BGA等先进封装产品,降本效果显著;

2、先进封装技术研发与应用取得重要突破,FC(Flip Chip)新技术及其产品在国内第一家实现了规模化量产;

3、"02"项目扎实推进;

4、知识产权方面的工作也取得新的成绩,公司成为江苏省专利先进单位。2013年,公司新申请专利61件,获得授权的专利38件。

(三)内部管理方面

1、公司SAP/MES计算机生产经营管理系统上线运行,提高了公司的信息化系统整体集成能力;

2、公司聘请了多个顾问团队,为公司在HR、IT、运营、设备管理等方面的提升提供指导和帮助。

(2)主营业务分析

公司主营业务为集成电路封装测试。报告期内,以智能手机为主的智能终端产品市场规模扩大,带动了公司元器件产品销售的增长。

单位:元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
营业收入	1,767,322,278.64	1,590,025,442.22	11.15%
营业成本	1,474,228,922.71	1,364,434,263.33	8.05%
期间费用	247,972,588.28	207,860,728.62	19.30%
归属于上市公司股东的净利润	60,660,291.84	37,840,342.98	60.31%
研发投入	87,501,922.04	86,031,128.85	1.71%

(3)核心竞争力分析

(一)公司产品技术情况

公司专业从事集成电路封装、测试业务,并提供相关技术支持和服务,可提供从芯片测试、组装到成品测试的"一站式"(One Stop Solution)服务。公司拥有几十个系列、五百多个品种产品,主要封装产品包括SOP/SOT/TSSOP、QFP/LQFP、MCM(MCP)、QFN/PDFN、BGA、SiP、BUMP、WLCSP、Cu pillar、FC(Flip Chip)等系列产品,并提供微处理器、数字电路、模拟电路、数模混合电路、射频电路的FT测试及PT圆片测试服务。

(二)主要产品获国家/省级项目立项、成果鉴定情况

公司近年承担并完成了多项国家、省市级科技项目,2009年开始承担国家科技重大专项02专项计划,2013年,公司IGBT封装技术开发及产业化项目获得国家火炬计划产业化示范项目立项。

2013年,我司科技创新取得重大突破,一批科研成果涌现,荣获国家、省市各类奖项:"高密度BUMP6000CPU芯片封装产品"认定为国家重点新产品;"FCCSP封装技术产品"荣登中国半导体创新产品及技术奖;"高密度TCB FCBGA封装技术产品"认定为江苏省高新技术产品;"高密度凸点(BUMP)技术产品"获江苏省科技进步三等奖;"晶圆级封装(WLP)技术产品"获得南通市科技进步一等奖;"IGBT产品及模块封测技术"获得南通市科技进步三等奖;"半导体塑封体及分层扫描方法"荣获江苏省第八届专利项目优秀奖。

(三)研究开发情况

公司围绕主业发展战略,遵循"一站式解决方案"经营理念,倡导"绿色环保"的发展潮流,坚持技术创新,不断推出满足市场需求、高科技、高附加价值产品,力争使公司产品技术始终保持行业领先水平。

1、研发机构设置

公司建有国家级博士后科研工作站、江苏省企业院士工作站、省级技术中心和工程技术研究中心等高层次创新平台,拥有一支专业的研发队伍,从事新品、新技术开发的科研人员达五百余人。其中,引进国家千人计划海外高层次技术人才、江苏省双创计划引进海外高层人才、省"六大人才高峰"计划引进人才、南通市江海英才人才计划引进海内外高层技术人才若干名;教授级高工1人、高工14人、博士后1人,并与中科院微电子所、中科院微系统所、清华大学、北京大学、华中科技大学等知名科研院所和高校建立了长期合作关系,聘请多位专家共同参与新品新技术的开发工作。

2、技术创新,持续研发能力

公司承担了"十一五"、"十二五"国家科技重大专项("02"专项)"先进封装工艺开发及产业化"、"国产关键设备、材料应用工程"和"高集成度多功能芯片系统级封装技术研发及产业化"等项目,已获国拨及地方配套资金共计约3.77亿元。专项实施以来,取得丰硕技术创新成果。公司WLCSP、FC(Flip Chip)、SiP、高可靠汽车电子封装技术、BGA基板设计及封装技术及高密度bumping技术全部实现量产化。

3、知识产权、专利申报

公司拥有MCM、SiP、QFN、BGA、汽车电子封装技术、BUMP、WLP、FC CSP等多项技术的独立自主知识产权。截至报告期末,公司已累计申报专利278项,已获得授权专利127项,其中授权发明专利34项,此外,还有一批专利正在编制申报之中。

(四)对外合作情况

公司紧紧抓住国际产业调整的难得机遇,积极承接世界集成电路封测产业的转移。近年来,公司充分发挥技术水平和产业规模优势,全力推进对外合作向更深层次发展。

● 2009年6月,从日本富士通转移的LQFP先进封装生产线。目前已实现全面量产,成为公司重要的经济增长点。

● 2009年12月,收购了日本富士通BUMP先进封装生产线及相关技术。目前已形成月产5000片的生产规模,实现了公司圆片级封装的起步。

● 2010年8月,与日本富士通在南通合作设立研发中心,共同研发世界最高端封装技术。

● 2010年,进一步扩大与美国德州仪器(TI)公司的合作,积极承接TI封测业务的转移,被TI授予"全球最佳供应商"殊荣。

● 2011年8月,与日本Tera Mikros(原卡西欧微电子)进行WLP先进封装产品和技术的合作。通过引进、吸收及再创新,仅用一年半的时间,公司的圆片级封装技术就达到了国际先进、国内领先的水平。

● 2012年2月,与日本富士通的合作取得积极成果,被授予优质供应商奖。

● 2012年9月,与日本富士通进一步深化合作,在WLCSP圆片封装技术的基础上,引进了Cu Pillar封装技术许可,使公司实现了圆片铜柱凸点制造、FC封装一条龙服务的新封装模式。

(4)公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势

集成电路产业是国家战略性新兴产业,是国民经济和社会信息化的重要基础。我国政府为保障国家信息安全,提高产业核心竞争力,改变重视集成电路产业发展现状,强调加快推动我国集成电路产业跨越式发展。工信部等相关部委正在积极制定推动颁布新的集成电路产业发展政策。随着集成电路发展频要及地方扶持政策的相继落地,将进一步完善集成电路产业发展政策体系,优化我国集成电路产业发展环境,对我国集成电路产业长期健康发展起到重要引领作用。在产业新政的刺激下,我国集成电路产业发展将翻开新的篇章。

我国目前是全球计算机、手机、通信设备、消费类电子等产品的主要产地和出口基地,主要产品产量占据全球50%以上。伴随互联网、移动通信、消费电子产业近十年的蓬勃发展,推动我国成为全球最大、增长最快的集成电路市场。但另一方面,国内集成电路市场依然会面临"外资为王"的尴尬处境,大量产品必须依靠进口才能满足工业生产所需,年进口总额将依然保持增长趋势。海关统计显示,2013年全年,我国集成电路进出口总值达到3199亿美元,同比增长29%,保持快速增长势头。其中,出口额为880亿美元,同比增长63%;进口额为2322亿美元,同比增长20%,贸易逆差达1441亿美元,较上年同期的1391亿美元扩大50亿美元,连续第四年扩大。预计2014年我国集成电路进出口将保持快速增长势头,未来市场潜力巨大。

在国家对信息安全建设重视程度提高、移动互联市场进一步发展的背景下,国家信息安全建设、移动互联网、信息消费、新能源汽车、高端装备等领域的快速发展,将为中国集成电路产业发展提供强力支撑。

(二)公司面临的市场竞争格局及竞争优势

在市场竞争格局方面,目前国内集成电路封装测试企业已构成外商独资、中外合资和内资三足鼎立的格局,其中,国际大型半导体企业纷纷在华建厂,无论在规模还是技术水平上占据着明显的优势。但同时,我国作为集成电路最大消费国,电子产品最大制造国,集成电路代工发展最快国,从成本和物流周期角度出发,必将进一步加快全球集成电路代工向中国国内转移的步伐。加之政策扶持给中国大陆的封测企业提供了一个赶超世界一流半导体企业的绝佳机会。

工欲善其事,必先利其器。公司通过引进、消化、吸收再创新,不断提高自有研发技术,公司作为国家科技重大专项"02"专项的责任单位,重点开发的BUMP、WLCSP、FC(Flip chip)等技术已接近或达到了国际先进水平。同时依托长年积累的对外合作的基础和优势,在继续服务好国外大客户的同时,积极开拓与国内品牌圆制造及设计公司的合作与服务,不断扩大内销市场份额。

(三)公司发展战略及规划

1、发展战略

本公司坚持"服务与创新,进取与和谐"的经营理念,贯彻"顾客满意第一"的经营宗旨,为客户提供"一站式解决方案",坚持主业发展的指导方针,奉行稳健、务实的经营风格,倡导科技创新和个性化服务,使公司在市场开发、技术创新、内部管理和资本运作方面均衡发展;坚持以人为本,尊重每一个员工的创造性和个性化,通过机制安排、制度建设、环境创造激发每一个员工的积极性;注重企业的社会责任,以信誉立身,公司经营成果分享于顾客、员工、股东与社会之间,追求公司股东、债权人、客户、员工的和谐价值实现,努力使公司成为"中国第一、世界一流"的集成电路封装测试企业,成为世界集成电路行业高端领域专业的封装测试服务提供商,力争早日进入全球封测行业前十强,并且努力使排名不断向前。

2、公司2014年度经营目标

2014年度生产经营目标为全年实现营业收入21.20亿元。该生产经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、公司经营等多种因素,存在一定的不确定性。

为实现2014年度生产经营目标,公司将重点做好以下几个方面工作:

(1)把开拓市场放在首位,确保充足的订单是目标实现的前提,在服务好老客户的同时,奋力开发潜在大客户,重点拓展台湾、韩国和国内市场,我们将主动出击,更贴近客户,为客户提供更及时、优质的产品服务。

(2)继续做好产品结构调整工作,适合市场的产品、满足市场的产能,是实现目标的基本条件,这些年,公司通过持续的技术改造、科技创新,产品结构调整工作基本到位,已基本完成世界一流的先进封装技术的布局。然而,任何一个先进技术,从研发、应用到普及,市场需要一个培育的过程。2014年,公司继续坚持长远发展与当前利益相兼顾的原则,继续坚持先进封装与传统封装同步发展的理念。同时,依据市场变化,及时做好不同封装形式的产品产能调整工作。

(3)继续做好人力资源工作,继续做好人才培养、人才引进工作,加快现有人才的培养使用,做好关键人才、高端人才引进工作,公司将从提高劳动生产率,提高员工积极性,实现双赢的角度出发,多动脑筋,集思广益。

(4)加快做好内部管理相档升级工作。运转灵活、高效的内部运行机制,是实现目标的保证,2014年,我们要继续围绕客户满意第一,进一步做好内部管理提档升级工作,通过组织层面(职能、分工、队伍建设)的优化、内外部服务能力的提高、专业化系统化体系的规范和完善、标准化流程与程序的完善等几方面,实现全方位工作质量、工作效率的提档升级,从而实现客户对公司满意度的提档升级。

3、为实现公司发展战略的资金需求及使用计划

为保证公司当前业务所需,实现2014年度经营生产目标,完成在建投资项目,并为今后的发展做适当准备,公司计划2014年内在土地、设施建设、生产设备、动力供应上投资约4.84亿元。

公司通过积极承担国家科技重大专项,继续获得国家专项资金支持;维护好银企关系,确保在需要银行信贷资金时,能够快速得到银行贷款。

(四)公司的风险因素及应对措施

1、行业波动性风险

全球集成电路行业具有技术呈周期性发展和市场呈周期性波动的特点,半导体行业与市场的波动会对公司的经营业绩产生一定影响,公司将密切关注市场需求动向,积极进行产品结构调整,加快技术创新步伐,降低行业波动给公司带来的经营风险。

2、新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险

目前新兴产业、智能产业的发展对集成电路产品的要求也会越来越高,公司通过承担国家"02"专项,已经取得一定的科研成果,公司研发的新技术、新工艺、新产品在产业化过程中,如出现一些波折或反复,将给公司生产经营造成一定影响。对此,公司通过引进高层次研发人才,主攻技术含量高、市场需求大的新产品,努力在技术研发层面上少走弯路;公司核心技术骨干和管理力量也将优先服务于新技术、新工艺、新产品,配合客户做好产品认证工作,提前预测产业化过程中有可能出现的问题,做好对策分析工作,缩短客户认证时间,确保新产品如期产业化。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

南通富士通微电子股份有限公司
董事长:石明达
2014年03月27日

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2014-011

南通富士通微电子股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南通富士通微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十六次会议,于2014年3月12日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知,并于2014年3月27日在南通新区会议中心会议室召开。会议由公司董事长石明达先生主持。本次董事会应到董事11名,实到董事10名。渡部潔董事因工作原因无法亲自出席会议,对于本次董事会议案,其委托福井明人董事参加会议并行使表决权利。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2013年度总经理工作报告》

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

2、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》

截至2013年12月31日,公司资产总额为3,686,188,070.23元人民币,负债总额为1,430,065,292.92元人民币,股东权益总额为2,256,122,777.31元人民币;2013年,公司实现营业收入1,767,322,278.64元人民币,实现利润总额70,614,818.42元人民币,实现净利润60,660,291.84元人民币。

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

3、审议通过了《公司2014年度经营目标和投资计划》

(1)公司计划2014年实现营业收入21.20亿元,较2013年实绩增长20.00%。

单位:(人民币)亿元

2014年计划营业收入	2013年实际营业收入	增减变动百分比
21.20	17.67	20.00%

上述经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营层的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,敬请投资者注意。

为实现上述经营目标,并为2015年的生产经营做适当准备,公司计划2014年内在土地、设施建设、生产设备、动力供应上投资约4.84亿元,主要用于BGA/QFN/FC等封装技术产品扩产、以及12寸Cu pillar等先进封装技术的产业化建设。

(2)为参与实施2014年度"02"项目,公司根据已经确定项目课题,计划在2014年~2016年自筹资金不超过一亿元,主要用于TSB~NCP等技术为基础的高密度系统集成封装量产技术开发及产业化。

公司参与2014年度"02"专项项目的实施,不仅可获中央、地方财政资助,更重要的是通过与国内设计公司在项目上的合作,加深合作,实现共赢。

公司董事会同意公司在2014年~2016年自筹资金不超过一亿元,并组织实施相关项目(课题)。自筹资金主要来源于公司自有资金及银行借款。

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

4、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》

经审计,2013年度母公司单独实现净利润56,880,512.96元,根据《公司章程》的规定按10%的比例提取法定盈余公积金5,688,051.30元。减去公司2012年度派发现金股利12,997,334.40元(含税),加上年初未分配利润383,069,539.71元,2013年度可供股东分配的利润合计为421,264,666.97元。

2013年度公司以2013年12月31日的总股本649,866,720股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),合计派发现金红利12,997,334.40元(含税)。2013年度,公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

上述利润分配预案符合公司章程中关于现金分红政策的相关规定。

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

5、审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司2014-013号公告。

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

6、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

7、审议通过了《公司2013年度报告及摘要》

具体内容详见公司2014-014、2014-015号公告。

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

8、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》

2013年度董事会工作报告详见公司2013年度报告"第四节"董事会报告"。

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

9、审议通过了《关于公司2014年与南通华达微电子集团有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》

具体内容详见公司2014-016号公告。

根据《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的有关规定,在审议公司与南通华达微电子集团有限公司及其关联方的关联交易时,与此有关联关系的董事石明达董事、石磊董事、高峰董事以及夏鑫董事进行了回避,实际有表决权的票数为七票。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

10、审议通过了《关于公司2014年与富士通(中国)有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》

具体内容详见公司2014-016号公告。

根据《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的有关规定,在审议公司与富士通(中国)有限公司及其关联方的关联交易时,与此有关联关系的渡部潔董事、福井明人董事、堀仁董事进行了回避,实际有表决权的票数为八票。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。

11、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,聘期为一年。

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

12、审议通过了《公司及全资子公司2014年与银行签署授信协议及公司为全资子公司提供担保的议案》

(1)根据2014年度生产经营的需要,公司在2014年内,计划与各银行合计签署32.3242亿元人民币的综合授信协议以及3,550万美元的综合授信协议。

(2)公司全资子公司海耀实业有限公司因业务需要,拟向银行申请综合授信额度1,000万美金。同意公司为该授信提供连带责任保证担保。

海耀实业为公司全资子公司,公司为海耀实业提供担保,有利于海耀实业正常经营业务需要,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

授权公司董事长石明达先生在以上最高限额内,根据实际经营情况实施,并与各银行具体办理综合授信事宜。

授权公司董事长石明达先生根据海耀实业的实际需要,在上述担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

公司为全资子公司提供担保的具体内容详见公司2014-017号公告。

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

13、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司2014-018号公告。

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

14、审议通过了《召开2013年度股东大会的议案》

具体内容详见公司2014-019号公告。

表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权。

以上议案2、议案3、议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12,董事会决定提交公司2013年度股东大会审议。

公司独立董事已对本次董事会中讨论的相关事项发表了独立意见,上述独立意见、相关公告以及报告内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司相关公告全文同时刊登在2014年3月29日出版的《证券时报》上。

三、备查文件

1. 南通富士通微电子股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

2. 独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

南通富士通微电子股份有限公司董事会
2014年3月27日

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2014-012

南通富士通微电子股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南通富士通微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次会议,于2014年3月12日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知,并于2014年3月27日在南通新区会议中心会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张润先生主持,公司全体3名监事;张润先生、戴玉峰女士、曹藤隍一先生均行使了表决权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》

截至2013年12月31日,公司资产总额为3,686,188,070.23元人民币,负债总额为1,430,065,292.92元人民币,股东权益总额为2,256,122,777.31元人民币;2013年,公司实现营业收入1,767,322,278.64元人民币,实现利润总额70,614,818.42元人民币,实现净利润60,660,291.84元人民币。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

2、审议通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会认为,公司建立了较为完善的内控制度,并能得到有效执行。《公司2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制建设和运行的情况。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

3、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

4、审议通过了《公司2013年度报告及摘要》

具体内容详见公司2014-014、2014-015号公告。

经审核,监事会认为董事会编制和审核南通富士通微电子股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

5、审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为,公司2013年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

具体内容详见公司2014-013号公告。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

6、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》

经审计,2013年度母公司单独实现净利润56,880,512.96元,根据《公司章程》的规定按10%的比例提取法定盈余公积金5,688,051.30元。减去公司2012年度派发现金股利12,997,334.40元(含税),加上年初未分配利润383,069,539.71元,2013年度可供股东分配的利润合计为421,264,666.97元。

2013年度公司以2013年12月31日的总股本649,866,720股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),合计派发现金红利12,997,334.40元(含税)。2013年度,公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。

上述利润分配预案符合公司章程中关于现金分红政策的相关规定。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

7、审议通过了《关于公司2014年与南通华达微电子集团有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》

具体内容详见公司2014-016号公告。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

8、审议通过了《公司2013年度募集资金使用情况专项报告》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

9、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

10、审议通过了《公司2014年度经营目标和投资计划》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

11、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核,监事会认为,公司募集资金投资项目已基本建设完成,将节余募集资金1,475.03万元(包括利息收入)永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关决策程序符合有关法律、法规的规定,同意将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

12、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司2014-018号公告。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

以上议案2、议案3、议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12,需提交公司2013年度股东大会审议。

相关公告及报告内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司相关公告全文同时刊登在2014年3月29日出版的《证券时报》上。

三、备查文件

1. 南通富士通微电子股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司监事会
2014年3月27日

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2014-013

南通富士通微电子股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本公司2013年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次募集

经中国证券监督管理委员会证监发行字(2007)192号文核准,本公司通过深圳证券交易所系统于2007年8月首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票6,700万股,发行价为每股8.82元。截至2007年8月7日,本公司共募集资金59,094万元,扣除发行费用2,659.52万元后,募集资金净额为56,434.48万元。

上述募集资金净额经北京京都会计师事务所有限责任公司北京京都验字(2007)第042号验资报告验证。

2、增发募集

经中国证券监督管理委员会证监许可(2010)1590号文核准,本公司通过深圳证券交易所系统于2010年11月向社会公开增发人民币普通股(A股)股票5,906.67万股,发行价为每股16.93元。截至2010年11月22日,本公司共募集资金99,999.92万元,扣除发行费用3,773.90万元后,募集资金净额为96,226.02万元。

上述募集资金净额经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字(2010)第173号验资报告验证。

(二)募集资金使用及节余情况

截至2013年12月31日,公司募集资金投资项目已全部实施完毕,达到预计可使用状态。本次募集资金投资项目实际投资总额为96,217.50万元。

单位:万元

承诺投资项目	承诺募集投资总额	截至2013年12月31日累计投入金额
集成电路封装测试(二期扩建工程)技术改造项目	50,000	50,060.04
集成电路封装测试(三期工程)技术改造项目	50,000	46,157.46

截至2013年12月31日,公司募集资金具体使用及节余情况列表:

单位:万元

募集资金总额	99,999.92
减:发行费用	3,773.90
募集资金净额	96,226.02
减:募集资金投资新项目实际投资金额	96,217.50
加:扣除银行手续费后的利息收入净额	1,466.51
募集资金节余(含利息)总金额	1,475.03

(三)募集资金节余的主要原因

1.募集资金存放期间产生了一定的利息收入。

2.在募投项目建设过程中,在保证项目建设质量的前提下,公司严格控制募集资金的支出,充分考虑资源的综合利用,加强了对项目费用的控制、监督和管理,相应地减少了部分项目的开支。

四、节余募集资金的使用计划

截至2013年12月31日,募集资金投资项目已全部完成,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定,为了提高节余募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,为公司和股东创造更大的利益,公司拟使用节余募集资金合计1,475.03万元(包括利息收入)永久补充流动资金。

本次节余募集资金补充流动资金,主要用于公司日常经营活动。本次使用节余募集资金永久补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的,没有改变或变相改变募集资金用途;未影响募集资金投资项目正常进行。

五、独立董事、监事会、保荐机构意见

(一)独立董事意见

本次将节余募集资金永久补充流动资金,符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,并不影响募集资金投资项目实施,不存在违规使用募集资金的情形,有利于充分利用募集资金,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,并且相关决策程序合法合规。因此,独立董事同意公司将节余的募集资金1,475.03万元(包括利息收入)永久补充流动资金。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为,公司募集资金投资项目已基本建设完成,将节余募集资金1,475.03万元(包括利息收入)永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关决策程序符合有关法律、法规的规定,同意将节余募集资金永久补充流动资金。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次拟将节余募集资金及利息合计1,475.03万元永久补充公司日常经营所需流动资金,该事项已经公司董事会、履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定;本次公司将节余募集资金永久补充流动资金,符合公司实际运营的需要,能有效提高资金使用效率,降低财务费用,符合全体股东的利益,保荐机构对公司将节余募集资金永久性补充日常经营所需流动资金无异议。

六、备查文件

1、南通富士通微电子股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议;

2、南通富士通微电子股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议;

3、独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;

4、招商证券股份有限公司关于南通富士通微电子股份有限公司节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见。

特此公告!

南通富士通微电子股份有限公司董事会
2014年3月27日

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2014-014

南通富士通微电子股份有限公司2013年年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	通富微电	股票代码	002156
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	钱建中	丁燕	
电话	0513-85058919	0513-85058919	
传真	0513-85058929	0513-85058929	
电子信箱	nfme_stock@fujitsu-nt.com	nfme_stock@fujitsu-nt.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,767,322,278.64	1,590,025,442.22	11.15%	1,622,046,684.09
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,660,291.84	37,840,342.98	60.31%	49,028,221.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,543,501.43	15